

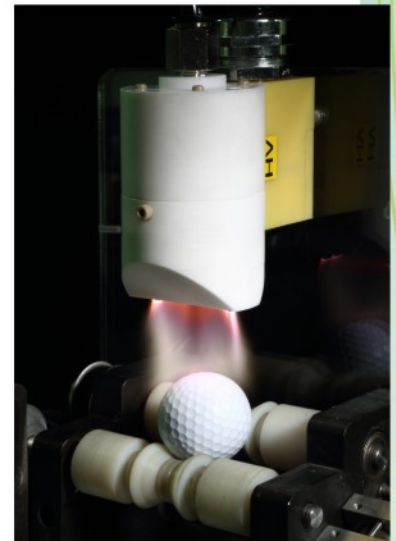
常压式等离子清洁设备 SAP002

在大气的环境下 快速的清除有机污染物

达到元件表面清洁及改善的功能，有效提升元件封装、黏著、印刷之可靠度

特点

- ✦ 专门为立体形状物件作处理，等离子喷射深度5cm，幅宽5cm
- ✦ 等离子效率高、处理速度快、清洁效能优异、操作成本低
- ✦ 内建气体源，亦可使用 N2、Ar
- ✦ 不须暖机，可随时启动停止
- ✦ PLC 控制，RS232 外界沟通
- ✦ 提升表面清洁度及粗糙度，增强贴合效果，改善各种胶、涂层的附着力
- ✦ 操作简单不需特别训练，可调整等离子功率、处理距离、清洁速度及气体的种类等
- ✦ 可清洁物品材质：玻璃、塑胶、陶瓷、橡胶等非金属材料



ABS面板



塑胶瓶



记忆卡

应用产业

- ✦ 医疗业：注射器、导管、培养皿杀菌
- ✦ 电子业：手机按键及外壳清洁活化
- ✦ 封装业：瓶罐及瓶盖贴合、涂装前处理
- ✦ 工业材料：圆管、圆柱、板材前处理
- ✦ 光学业：光纤、透镜、光栅清洁
- ✦ 各式基材表面之清洁、粗化、改质

项目	SAP002
功率	250W~500W
输入电源	AC220V,60HZ,1phase, 3phase, 10A,Ground<5Ω
气体压力	4.2±0.7kg/cm ²
气体流量	70L/Min
控制部尺寸	295(W)×385(D)×345(H) mm
重量	15Kg
电源部尺寸、重量	434(W)×384(D)×162(H) mm、5Kg
照射部尺寸、重量	64(W)×101(D)×124(H) mm、3Kg
清洁范围	5~50mm

